



**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE**

## **Digi International présente les dernières solutions de connectivité IoT et des cas d'utilisation client au salon Embedded World 2019**

*Digi va présenter ses ordinateurs monocartes et son System-on-Modules Digi ConnectCore 8X ainsi que les modules et modems Digi XBee3, au principal salon international de l'IoT*

**Nuremberg, Allemagne, 19 février 2019** – Digi International®, (NASDAQ : DGI, [www.digi.com](http://www.digi.com)), l'un des principaux fournisseurs de produits et de services de connectivité à l'Internet des Objets (IoT), a annoncé aujourd'hui qu'il présenterait ses ordinateurs monocartes (SBC) et son System-on-Modules (SOM) ConnectCore® 8X ainsi que la gamme de modules et modems Digi XBee3® au salon [Embedded World 2019](#). En outre, Digi organisera des démonstrations et des séances de formation qui illustreront les dernières avancées en matière de technologies intégrées et leurs capacités. Le salon Embedded World se déroulera au parc des expositions de Nuremberg, du 26 au 28 février 2019. Digi exposera ses solutions dans le Hall 3, stand 629.

Lors de cet événement, Digi présentera les kits de développement ConnectCore 8X, développés pour fournir aux ingénieurs hardware et software, aux spécialistes des technologies en entreprise et même aux enseignants et aux étudiants l'occasion d'acquérir une expérience pratique d'intégration de la connectivité à leurs solutions et applications IoT.

Exploitant le facteur de forme Digi SMTplus®, les ordinateurs monocartes et les System-on-Modules Digi ConnectCore 8X, très compacts, utilise la famille de processeurs NXP i.MX 8X, basée sur les cœurs ARM® Cortex®-A35 et Cortex-M4F. Conçu pour offrir une fiabilité et une liberté de conception optimales, le ConnectCore 8X propose une connectivité 2X2 MIMO 802.11ac + Bluetooth Smart, un traitement des vidéos, images et graphiques, des capacités audio/vocales, ainsi que la sécurité Digi TrustFence® pour les applications IoT avancées destinées aux secteurs fortement réglementés, notamment les secteurs de la santé/médical, industriel, du transport, de l'immobilier et de l'IHM avancée.

La gamme de modules RF intelligents et les modems cellulaires Digi XBee3 sont hautement intégrés, compacts et conçus pour supporter les innovations en matière d'IoT en périphérie de réseau. Offrant une approche modulaire de la connectivité IoT, la gamme Digi XBee3 permet l'intégration de nouvelles fonctions à une programmabilité MicroPython et à des radios bimodes et dispose de la capacité de mettre à jour les micrologiciels sans fil (OTA). Ces

fonctionnalités permettent ainsi une souplesse de conception sans fil, une intégration économique et un ajout de fonctionnalités personnalisé et facilité en périphérie de réseau. On obtient ainsi des solutions IoT innovantes pouvant être développées, prototypées et fabriquées en série plus rapidement.

« Une très grande partie de l'industrie de l'IoT tourne autour de la technologie intégrée et le salon Embedded World est le lieu idéal pour présenter les produits que Digi International apporte à l'industrie », a déclaré Mike Ueland, Président, Services et produits IoT, Digi International. « Nous sommes ravis de présenter plusieurs cas d'utilisation de notre offre de produits IoT lors de l'Embedded World qui nous sert de tremplin pour lancer nos produits, comme nous l'avons fait avec le Digi XBee3 lors de l'édition de l'année dernière et qui a rencontré un franc succès auprès de l'industrie ».

#### **Présentations et démonstrations de produits au programme :**

- **Digi ConnectCore 8X** : Digi fera des démonstrations des ordinateurs monocartes et des System-on-Modules Digi ConnectCore 8X en compagnie de NXP (Digi est un partenaire en accès anticipé de NXP). Par ailleurs, Au-Zone mettra en avant les capacités avancées d'apprentissage automatique, de reconnaissance d'images et de souplesse de conception.
- **Connectivité IoT à distance avec le modem cellulaire Digi XBee3** : Digi présentera ses solutions de gestion des dispositifs à distance entre un dispositif cellulaire Digi XBee3 et le Digi Remote Manager® basé sur le cloud en surveillant et en contrôlant à distance les dispositifs, directement à partir du site de l'exposition.
- **Mise en réseau complète de l'IoT avec Digi XBee3** : Digi présentera les dernières évolutions de la plate-forme Digi XBee3, notamment des supports multiprotocoles (Zigbee, CAT-1, LTE-M, NB-IoT + Bluetooth LE), avec une solution de mise en réseau de l'IoT composée de modules Digi XBee3, de passerelles industrielle Digi XBee® et d'outils de gestion de réseau/dispositif. Ces mises à jour offrent de nouveaux cas d'utilisation permettant d'améliorer l'installation, le diagnostic et la configuration des commandes locales. L'élément de gestion du réseau et du dispositif utilisera une nouvelle application mobile XCTU® pour configurer Digi XBee à l'aide d'un téléphone ou tablette via Bluetooth.
- **SteadyServ iKeg** : cette démonstration de l'application présentera SteadyServ iKeg, qui utilise des capteurs pour mesurer le volume d'un fût, analyser localement les données grâce à une passerelle industrielle Digi XBee, puis envoyer les analyses vers le cloud via une connexion Zigbee. L'application iKeg présente l'information basée sur le cloud aux gérants de bars afin de les aider à faire un inventaire précis et à passer leurs commandes de façon proactive lorsqu'ils sont à court de bière.

### Séance de formation

- Le mercredi 27 février, de 11h30 à 12h00, Andreas Burghart, ingénieur des ventes de solutions chez Digi International et Richard Elberger, architecte de solutions mondiales de partenariats IoT chez AWS, animeront une séance dans le cadre de la Séance 1.1 de l'Internet des Objets intitulée « Where the Cloud Meets the Edge: Five Tenets for Success at the Edge ». La séance traitera des capacités du cloud et de l'edge computing et portera sur la recherche du matériel adéquat pour fournir de l'intelligence là où l'entreprise en a le plus besoin.

### Co-exposants

- Outre son propre stand, Digi présentera des solutions sur l'ensemble du salon en compagnie de ses partenaires, notamment lors de la démonstration de réalité virtuelle des « Villes du futur » réalisée par Mouser (hall 3A, stand 111). Lors de cette démonstration, Digi présentera les passerelles industrielles Digi XBee XGI dans les sections « Digital Twinning » et « Smarter Edge ». Digi sera également présente auprès d'Arrow (hall 4A, stand 340), d'Atlantik Elektronik (hall 3, stand 141), d'Avnet Silica (hall 1, stand 370), d'AWS (hall 4, stand 568), de CODICO (hall 3, stand 310), de Digi-Key Electronics (hall 4A, stand 633) et de NXP Semiconductors (hall 4A, stand 220).

### Cliquez pour tweeter

Lors du salon #ew19, dans le Hall 3 Stand 629, @DigiDotCom présentera les ordinateurs monocartes et les System-on-Modules Digi ConnectCore 8X ainsi que la gamme Digi XBee3 conçue pour supporter les innovations en matière d'#IoT en périphérie de réseau.

<https://ctt.ec/em3J3> #ConnectWithConfidence #OneDigi

Pour de plus amples informations sur ces événements, rendez-vous sur :

<https://www.digi.com/pr/ew19>

### À propos de Digi International

Digi International®, (NASDAQ : DGII) est un leader mondial de produits et de services essentiels de connectivité IdO et *machine-to-machine* (M2M). Nous aidons nos clients à créer la prochaine génération de produits connectés. En outre, nous déployons et gérons des infrastructures de communication essentielles dans des environnements exigeants avec des niveaux de sécurité élevés, une fiabilité continue et des performances à toute épreuve. Fondée en 1985, nous avons aidé nos clients à connecter plus de 100 millions d'objets et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pour de plus amples informations, visitez le site internet de Digi en cliquant sur [www.digi.com](http://www.digi.com), ou appelez le 877-912-3444 (depuis les États-Unis) ou le +1 952-912-3444 (à l'international).

**Note aux éditeurs**

Pour organiser une présentation de produits ou un entretien avec un cadre de Digi au cours du salon Embedded World 2019, contactez Anthony Hildebrand ou John Waite de Catalyst For Content, à l'aide des coordonnées ci-après.

**Contacts presse :**

Europe

Anthony Hildebrand ou John Waite

Catalyst For Content

Bureau : +44 (0) 1753 648140

[anthony@catalystforcontent.com](mailto:anthony@catalystforcontent.com), [john@catalystforcontent.com](mailto:john@catalystforcontent.com)

Amérique du Nord

Joseph Rigoli

LEWIS

Bureau : +1 781-418-2400

[Digi@teamlewis.com](mailto:Digi@teamlewis.com)